



# 平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年2月5日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社  
 コード番号 8035 URL <http://www.tel.co.jp>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役 執行役員  
 四半期報告書提出予定日 平成25年2月13日  
 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(氏名) 竹中 博司  
 (氏名) 原田 芳輝

上場取引所 東  
 TEL 03-5561-7000

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成25年3月期第3四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24年12月31日)

### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年3月期第3四半期	358,511	△21.3	5,336	△87.6	8,805	△81.2	△936	—
24年3月期第3四半期	455,514	△4.7	42,953	△37.0	46,720	△34.9	27,412	△47.4

(注) 包括利益 25年3月期第3四半期 3,099百万円 (△85.6%) 24年3月期第3四半期 21,559百万円 (△54.9%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
25年3月期第3四半期	△5.23	—
24年3月期第3四半期	153.06	152.82

### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
25年3月期第3四半期	753,598	592,330	77.0
24年3月期	783,610	598,602	74.9

(参考) 自己資本 25年3月期第3四半期 580,475百万円 24年3月期 586,789百万円

## 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
24年3月期	—	53.00	—	27.00	80.00
25年3月期	—	25.00	—	—	—
25年3月期(予想)	—	—	—	26.00	51.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

平成25年3月期の第2四半期末配当金の内訳は、普通配当15円、記念配当10円です。  
 平成25年3月期の期末配当金の内訳は、普通配当16円、記念配当10円です。

## 3. 平成25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	495,000	△21.8	9,500	△84.3	4,500	△87.7	25.11

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 有
- ④ 修正再表示 : 無

第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

25年3月期3Q	180,610,911 株	24年3月期	180,610,911 株
25年3月期3Q	1,427,121 株	24年3月期	1,446,079 株
25年3月期3Q	179,175,008 株	24年3月期3Q	179,100,704 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】5ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

・当社は、平成25年2月5日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、開催と同時に当社ホームページに掲載する予定です。

## 【添付資料】

## [目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	4
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	5
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	6
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	6
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	6
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	6
3. 四半期連結財務諸表	7
(1) 四半期連結貸借対照表	7
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	8
(3) 継続企業の前提に関する注記	10
(4) セグメント情報等	10
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	10

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期連結累計期間においては、中国をはじめとする多くの新興国の成長率鈍化や欧州の債務問題、あるいは米国の歳出削減などによる先行きに対する懸念から、日本を含めた世界経済は総じて緩やかな成長に留まりました。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業においては、パソコン用新型基本ソフト発売によっても需要の喚起に結びつかず、パソコン販売台数は前年度割れとなりました。また、市場の牽引役であるスマートフォンも、先進国では既に広く普及が進んだことから年初に期待されたほどには伸びず、電子部品市況全般として低調に推移しました。

このような状況のもと、当第3四半期連結累計期間の連結業績は、売上高3,585億1千1百万円(前年同期比21.3%減)、営業利益53億3千6百万円(前年同期比87.6%減)、経常利益88億5百万円(前年同期比81.2%減)、また、四半期純損失は9億3千6百万円(前年同期は274億1千2百万円の四半期純利益)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

#### ① 半導体製造装置

パソコン販売回復の兆しは見えずパソコン用DRAMは不振が続き、スマートフォンやタブレットPC向けのモバイル用DRAMやフラッシュメモリの需要の伸びも鈍いことから、メモリーを中心とした半導体メーカーの生産調整は続いており、増産設備投資までには結びついていない状況です。一部のロジック系半導体向け先端設備投資は継続されたものの、半導体製造装置市場は全般的に調整局面が続いております。このような状況のもと、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、2,827億2千3百万円(前年同期比16.8%減)となりました。

#### ② FPD/PV (フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル) 製造装置

中小型パネルを中心に一部の高性能液晶パネルは伸びているものの、液晶パネルメーカーの生産調整は続いており、液晶パネル用製造装置の需要は低調に推移しております。このような状況のもと、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、139億1千2百万円(前年同期比73.9%減)となりました。

#### ③ 電子部品・情報通信機器

電子部品事業においては、デジタル家電関連製品及び産業機器関連製品の需要が停滞し、景気に対する不安感から国内ではIT投資を控える傾向が見られ、情報通信機器関連の販売も低調でした。このような状況のもと、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、615億7千万円(前年同期比0.5%減)となりました。

#### ④ その他

当セグメントの当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、3億5百万円(前年同期比1.6%減)となりました。

(ご参考)

## 【連結業績】

(単位：百万円)

	当期			
	第1Q	第2Q	第3Q	第3Q累計
売上高	134,179	132,421	91,910	358,511
半導体製造装置	108,703	105,963	68,056	282,723
日本	10,032	10,186	6,349	26,568
米国	26,629	29,152	28,879	84,661
欧州	10,457	12,944	7,673	31,075
韓国	24,214	14,463	5,759	44,436
台湾	29,338	29,456	15,238	74,033
中国	5,666	6,196	2,153	14,016
東南アジア他	2,363	3,563	2,003	7,930
FPD/PV製造装置	4,769	4,460	4,682	13,912
電子部品・情報通信機器	20,605	21,859	19,105	61,570
その他	101	137	66	305
営業利益(△損失)	9,283	2,918	△6,865	5,336
経常利益(△損失)	11,248	4,211	△6,654	8,805
四半期純利益(△損失)	5,720	370	△7,026	△936

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

## 【生産及び受注の実績】

## 1. 生産実績

(単位：百万円)

	当期			
	第1Q	第2Q	第3Q	第3Q累計
半導体製造装置	96,681	88,294	68,894	253,870
FPD/PV製造装置	2,121	4,511	3,030	9,663
合計	98,803	92,806	71,924	263,534

(注) 1. 金額は販売価格によっております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## 2. 受注実績(受注高)

(単位：百万円)

	当期			
	第1Q	第2Q	第3Q	第3Q累計
半導体製造装置	76,029	66,928	91,324	234,282
FPD/PV製造装置	2,829	8,085	3,673	14,588
電子部品・情報通信機器	22,631	20,658	18,548	61,838
その他	101	137	66	305
合計	101,590	95,810	113,612	311,014

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## 3. 受注実績 (受注残高)

(単位: 百万円)

	当期		
	第1Q末	第2Q末	第3Q末
半導体製造装置	157,737	118,702	142,654
F P D / P V 製造装置	12,260	15,885	23,298
電子部品・情報通信機器	15,809	14,608	14,051
その他	—	—	—
合計	185,807	149,196	180,004

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (2) 連結財政状態に関する定性的情報

## ① 財政状態

当第3四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ983億5千万円減少し、5,087億円となりました。主な内容は、受取手形及び売掛金の減少698億1千8百万円、有価証券に含まれる短期投資の減少267億9千万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から78億8千3百万円増加し、1,347億6千8百万円となりました。

無形固定資産は、のれんの増加541億6千9百万円などにより、前連結会計年度末から556億9千1百万円増加し、603億9千5百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から47億6千3百万円増加し、497億3千5百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から300億1千1百万円減少し、7,535億9千8百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ262億9千7百万円減少し、984億9千6百万円となりました。主として、支払手形及び買掛金の減少159億3千1百万円、前受金の減少91億3千5百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ25億5千8百万円増加し、627億7千2百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ62億7千2百万円減少し、5,923億3千万円となりました。主として、四半期純損失9億3千6百万円を計上したことによる減少、前期の期末配当48億3千7百万円及び当期の中間配当44億7千9百万円の実施による減少、円安の影響による為替換算調整勘定の増加45億1百万円によるものであります。この結果、自己資本比率は77.0%となりました。

## ② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ934億3千3百万円減少し、653億4千2百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資1,688億4千8百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ134億3千3百万円減少し、2,341億9千1百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動により獲得したキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ498億8千8百万円増加し、716億3千2百万円となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益93億4千9百万円、売上債権の減少759億8千2百万円、減価償却費184億2千6百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、仕入債務の減少202億7千1百万円、前受金の減少138億3千5百万円がキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主として定期預金及び短期投資の増加800億円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出550億6千8百万円、有形固定資産の取得による支出155億8千1百万円により、前年同期の191億7千6百万円に対し1,504億1千5百万円となりました。

財務活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払93億1千6百万円により、前年同期の244億6千4百万円に対し113億8千2百万円となりました。

## 【連結キャッシュ・フロー(要約)】

(単位：百万円)

	前第3四半期 連結累計期間	当第3四半期 連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,744	71,632
税金等調整前四半期純利益	45,979	9,349
減価償却費	17,014	18,426
売上債権の増減額(△は増加)	5,649	75,982
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,539	6,857
仕入債務の増減額(△は減少)	△8,457	△20,271
その他	△39,981	△18,713
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,176	△150,415
定期預金及び短期投資の増減額(△は増加)	12,000	△80,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等 による支出	—	△55,068
その他(固定資産の取得等)	△31,176	△15,346
財務活動によるキャッシュ・フロー	△24,464	△11,382
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,730	△3,268
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△23,626	△93,433
現金及び現金同等物の期首残高	165,050	158,776
現金及び現金同等物の四半期末残高	141,423	65,342
現金及び現金同等物並びに満期日又は償還日までの 期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の四 半期末残高	249,414	234,191

## (3) 連結業績予想に関する定性的情報

売上高につきましては、主力の半導体製造装置部門は前回予想と変更ありませんが、電子部品・情報通信機器部門（連結子会社の東京エレクトロン デバイス(株)が担当）の売上高予想が下方修正となったため、前回発表予想を下回る見通しとなりました。損益面につきましては、厳しい事業環境を受けコストの徹底的削減に取り組んでおりますが、半導体製造装置部門の製造子会社における生産高見通しが前回予想時に比べ減少したため、原価に対する固定費負担の相対的上昇が見込まれております。この影響と前述の売上高減少の影響などにより、営業利益・当期純利益が前回発表予想を下回る見込みとなりました。なお、今回の業績予想における税金費用には、各連結子会社の業績変動に伴う税負担率上昇の影響を反映しております。これにより、平成24年10月31日に公表した通期の連結業績予想を修正いたします。

## 平成25年3月期の連結業績予想

	通期予想
売上高	4,950億円 (前年同期比21.8%減)
半導体製造装置	3,930億円 (前年同期比17.8%減)
F P D / P V 製造装置	190億円 (前年同期比72.8%減)
電子部品・情報通信機器	825億円 (前年同期比 2.8%減)
その他	5億円 (前年同期比 8.4%増)
営業利益	95億円 (前年同期比84.3%減)
当期純利益	45億円 (前年同期比87.7%減)

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社グループが合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。



3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成24年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	35,834	49,191
受取手形及び売掛金	150,305	80,487
有価証券	211,790	185,000
商品及び製品	101,789	97,391
仕掛品	35,104	35,252
原材料及び貯蔵品	12,575	14,650
その他	61,026	47,503
貸倒引当金	△1,376	△775
流動資産合計	607,050	508,700
固定資産		
有形固定資産	126,885	134,768
無形固定資産		
のれん	—	54,169
その他	4,703	6,225
無形固定資産合計	4,703	60,395
投資その他の資産		
その他	48,819	53,472
貸倒引当金	△3,848	△3,737
投資その他の資産合計	44,971	49,735
固定資産合計	176,560	244,898
資産合計	783,610	753,598
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	46,986	31,055
製品保証引当金	8,903	8,482
その他の引当金	9,077	3,532
その他	59,826	55,426
流動負債合計	124,794	98,496
固定負債		
退職給付引当金	54,646	56,032
その他の引当金	619	567
その他	4,947	6,171
固定負債合計	60,213	62,772
負債合計	185,007	161,268
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,023	78,023
利益剰余金	471,186	460,911
自己株式	△9,747	△9,611
株主資本合計	594,422	584,283
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,575	2,927
繰延ヘッジ損益	△51	△79
為替換算調整勘定	△11,157	△6,656
その他の包括利益累計額合計	△7,633	△3,808
新株予約権	1,156	1,298
少数株主持分	10,656	10,556
純資産合計	598,602	592,330
負債純資産合計	783,610	753,598

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 四半期連結損益計算書  
 第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)
売上高	455,514	358,511
売上原価	300,532	244,622
売上総利益	154,981	113,889
販売費及び一般管理費		
研究開発費	59,872	54,859
その他	52,155	53,692
販売費及び一般管理費合計	112,027	108,552
営業利益	42,953	5,336
営業外収益		
受取利息	535	1,022
為替差益	1,089	—
その他	2,426	2,924
営業外収益合計	4,052	3,947
営業外費用		
為替差損	—	227
その他	285	251
営業外費用合計	285	478
経常利益	46,720	8,805
特別利益		
固定資産売却益	13	930
償却債権取立益	1,437	—
その他	171	—
特別利益合計	1,622	930
特別損失		
固定資産除売却損	225	91
災害による損失	938	—
関係会社整理損	—	133
組織再編費用	—	132
その他	1,199	29
特別損失合計	2,363	386
税金等調整前四半期純利益	45,979	9,349
法人税等	18,252	7,916
過年度法人税等	—	2,194
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	27,726	△760
少数株主利益	313	175
四半期純利益又は四半期純損失(△)	27,412	△936

四半期連結包括利益計算書  
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失 (△)	27,726	△760
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,249	△643
繰延ヘッジ損益	6	△34
為替換算調整勘定	△4,923	4,539
その他の包括利益合計	△6,167	3,860
四半期包括利益	21,559	3,099
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	21,275	2,888
少数株主に係る四半期包括利益	283	211

## (3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

## (4) セグメント情報等

## ① 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」、「FPD/PV(フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル)製造装置」及び「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD/PV製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置及び薄膜シリコン太陽光パネル用製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「電子部品・情報通信機器」は、集積回路(IC)を中心とした半導体製品、その他電子部品、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア等の設計・開発・仕入・販売等を行っております。

## ② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第3四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年12月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD/PV 製造装置	電子部品・ 情報通信機器				
売上高	282,751	13,912	62,145	8,399	367,209	△8,698	358,511
セグメント利益 又は損失(△)	33,626	△5,389	861	1,007	30,105	△20,755	9,349

- (注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流、施設管理及び保険業務等を含んでおります。
2. セグメント利益又は損失の調整額△20,755百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△15,156百万円であります。
3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

## ③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

当第3四半期連結会計期間において、FSI International, Inc.(米国)、Magnetic Solutions Ltd.(アイルランド)及びOerlikon Solar Holding AG(スイス)の全株式を取得し、連結子会社としました。当該事象により発生したのれんの金額は、「半導体製造装置」セグメントにおいて13,761百万円、「FPD/PV製造装置」セグメントにおいて21,786百万円であります。なお、のれんの金額は取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

## (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。